

PR29634

JBN 外0317 (産業、半導体) (08・3・19)

【産業担当デスク殿】29634

◎ASIP向け再受動化技術論文 CMDがWLCSPフォーラムで発表

【スコッツデール (米アリゾナ州) 19日PRN=共同JBN】カリフォルニア・マイクロ・デバイセス (CMD) は19日、3月17-20日に米アリゾナ州スコッツデールのラディソンフォート・マクダウェルリゾーツ・アンド・カジノで開かれているデバイス・パッケージングに関する国際マイクロエレクトロニクス・パッケージング協会 (IMAPS) 第4回国際会議・展示会で、アプリケーション特定用途向け集積化受動 (ASIP: 商標) 製品における無給電素子を最小化する目的の新しいチップスケール・パッケージ (CSP) 再受動化技術に関する技術論文を提供すると発表した。このプレゼンテーションは、ウエハーレベル・チップスケール・パッケージ (WLCSP) ボードの信頼性に関するWLCSPフォーラム主催の技術論文発表会の一環である。

▽新しいCSP製造技術はASIP性能と信頼性を向上する

論文は「ASIP製品における無給電素子を最小化する目的の新しい再受動化/二重金属層再分配(RDL)・CSP技術」と題し、WLCSP技術における無給電キャパシタンスの役割に応え、CSPベースの静電放電 (ESD) 保護と電磁妨害 (EMI) フィルター、強化された熱機械的信頼性の電气的性能向上につながりうるよう最適化されたWLCSP向け再受動化/RDL技術を説明する。論文はカリフォルニア・マイクロ・デバイセスのファウンドリー・エンジニアリング・オペレーション担当ディレクターのウメシュ・シャルマ博士から公表される。論文は会議後にカリフォルニア・マイクロ・デバイセスのウェブサイト (<http://www.cmd.com/applications/papers.php>) もしくはWLCSPフォーラムのウェブサイト (<http://www.wlcsforum.org>) からダウンロードして入手できる。

▽WLCSP信頼性に関するパネルディスカッション

WLCSPフォーラムはIMAPSデバイス・パッケージング会議中に、WLCSPボードの信頼性について2つのパネルディスカッションを主催する。第1のセッションは3月18日に開催され、カリフォルニア・マイクロ・デバイセスの新しい再受動化/RDL・CSP技術とWLCSPフォーラム会員社が執筆し、公表するその他4つの技術論文が発表される。パネルディスカッションはカリフォルニア・マイクロ・デバイセスのマーケティング担当副社長でWLCSPフォーラム会長であるカイル・ベーカー氏の共催である。

▽カリフォルニア・マイクロ・デバイセスについて

同社は携帯機器、デジタル・コンシューマー・エレクトロニクス、パソコン各市場向けの特用途アナログおよびミクスドシグナル半導体製品の有力サプライヤーである。主要製品は、携帯機器向け保護デバイス、デジタルTVなどデジタル・コンシューマー・エレクトロニクス、パソコン、携帯機器ディスプレイ用アナログおよびミクスドシグナルICなどが含まれる。

同社と製品の詳しい情報はウェブサイト (<http://www.cmd.com>) まで。

ASIPとApplication Specific Integrated Passive (アプリケーション・スペシフィック・イン

テグレートッド・パッシブ) は、カリフォルニア・マイクロ・デバイセスの商標。その他の商標はそれぞれの所有者に帰属する。

(了)

▽問い合わせ先

Richard Haas of California Micro Devices

+1-408-934-3108

richardh@cmd.com

Web site: <http://www.cmd.com>